中信证券股份有限公司

关于有研半导体硅材料股份公司

使用部分超募资金新建募集资金投资项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对有研硅使用部分超募资金新建募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,714.3158 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 9.91 元。本次公开发行募集资金总额为 185,458.87 万元，扣除总发行费用 19,062.15 万元（不含增值税），募集资金净额为 166,396.72 万元。上述募集资金已全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 7 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2201588 号）。

（二）超募资金使用情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 19,500.00 万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 19,000.00 万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司于 2024 年 2 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划。具体详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 28 日和 2024 年 5 月 6 日披露的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》、《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》和《有研硅关于回购完成暨回购实施结果的公告》。

根据公司募投项目规划，首次公开发行超募资金总额为 6.63 亿元。截至 2025 年 6 月 30 日，已使用 3.85 亿元用于永久补充流动资金，0.36 亿元（含印花税、交易佣金等交易费用）用于股份回购，尚未使用的超募资金余额为 2.43 亿元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐人中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司

山东有研半导体材料有限公司已与保荐人中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议对本公司（及子公司）、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2025 年 06 月 30 日，公司均严格按照该募集资金专户存储三方/四方监管协议的约定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行名称	银行账号	金额
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	3,757.58
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	184.22
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	3,227.52
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	93.36
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	6,314.07

注：上述专户存储金额不包含用于现金理财的募集资金 5.00 亿元。

三、本次使用超募资金新建投募项目的具体情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：8 英寸区熔硅单晶技术研发及产业化

2、建设地点：北京市顺义区双河大街 10 号

3、建设单位：有研半导体硅材料股份公司

4、项目建设期周期：2025 年 7 月至 2026 年 12 月

5、投资金额及资金来源：计划投资金额人民币 4,833 万元，资金来源为公司部分超募资金。

6、建设内容：

（1）项目资金将用于 8 英寸区熔硅单晶技术研发及产业化；

（2）项目改造主要涉及区熔炉二次配等工作，不涉及厂房基础结构的变化；

（3）项目固定资产投资主要为区熔单晶炉、晶体加工设备，用于 8 英寸区熔单晶的产能和技术提升，建成后可新增 8 英寸区熔单晶产能 21 吨/年。

投资类型具体如下：

投资类型	设备	金额（万元）
固定资产	区熔单晶炉	4,500
	晶体加工设备	130
设备二次配工程	-	100
流动资金	-	103
合计	**-**	**4,833**

注：设备二次配工程是指在洁净室投入运转后，在对原有洁净室区域的洁净度、空气分子污染程度、微振动、温度、湿度、气压、静电等指标影响最小的情况下，为新接入设备和生产线做二次洁净室配套（如电力系统、水处理系统，气流风路系统等）工程。

本项目的实施将进一步提升公司区熔硅单晶技术的水平，有利于发展 8 英寸区熔硅单晶、拓展区熔高端市场，提高区熔硅单晶市场占有率，对公司经营业绩将产生积极的影响。本项目的实施，有利于提升我国半导体硅材料行业的整体水平，推动国内相关新型电力电子器件、节能型功率器件等产业的发展，实现高端硅材料的规模化生产，增强我国功率器件用硅基材料国际竞争力，进一步拓展国际市场，对提升我国区熔硅单晶材料水平起到积极的推动作用。

（二）项目相关行业背景及必要性

区熔单晶硅是电子信息产业中的基础性材料，其相比于半导体产业常用的直拉单晶硅，具有高纯、低氧、高阻等特性，有利于器件和电路实现耐高压、高频、高寿命和高转换率，主要用于 IGBT 和节能灯用稳压管及可控硅等电力电子器件、射频及微波器件、传感器、MEMS 器件、太阳能电池、探测器、LED 等。其中 IGBT 作为新一代的功率半导体器件，性能优异，是功率半导体中的关键产品门类，可适用于各类需要进行交直流转换、电流电压转换的应用场景，在电网输变电、新能源汽车、轨道交通、新能源、变频家电等领域发挥重要的作用。

目前，新能源汽车功率半导体需求持续攀升，将推动区熔硅片行业进入供需紧张状态。我国在区熔硅单晶领域起步较晚，大部分市场份额被国外企业占据，国内仅有少数

企业具备研发和产业化能力，特别是在代表先进技术水平的大尺寸区熔硅单晶领域，主要依赖进口，实现大尺寸区熔硅单晶的自主保障势在必行。公司将紧抓市场机遇，进一步提高 8 英寸区熔硅片的产能，不断扩大市场份额，实现营收稳步增长。

（三）项目实施的可行性

公司拥有经验丰富的研发团队，并在项目研发方向上的相关领域具备一定的技术积累。本项目的研发方向和研发内容符合半导体行业的发展趋势，与公司现有主营业务产品的技术关联度较高，现有技术积累为项目实施提供技术支撑。

从市场来看，本项目的技术成果仍然应用于区熔单晶产品的开发运营，产业化成果所面向的客户群体、目标市场与公司现有产品一致，可以共享公司现有的市场、客户等渠道资源。

（四）项目实施的风险分析

公司基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势等综合因素考虑，使用部分超募资金新建募集资金投资项目，存在如研发风险、市场竞争风险、项目建设风险、技术迭代风险等不确定因素，如果新建募集资金投资项目未能如期实现目标，或建成后市场情况发生不可预见的变化，可能存在市场拓展无法在预定时间内达到预期效果、市场开发投入超出预算的风险。

另外，本项目的风险主要来自于市场需求的变化以及由于市场变化带来的价格降低。区熔单晶硅将面临超低氧 MCZ 替代、SiC 替代和 12 英寸迭代的多重压力，但中高压器件需求及新兴市场扩张仍提供缓冲空间。区熔单晶硅准入门槛非常高，产业集中度较高，一般企业较难进入。因此，未来区熔单晶市场竞争压力仅集中在少数几个厂家当中，主要风险将集中到产品品质竞争和价格走低上，公司有着丰富的生产经验和技术积累，未来公司将通过提高产品良率降低成本，不断提高市场竞争优势。

四、项目实施对公司的影响

公司使用部分超募资金投资建设新项目系根据公司发展战略、围绕行业发展趋势和市场需求进行的产品布局，符合公司业务发展方向，可带动公司针对现有产品进行升级研发，预期本项目实施后，将对公司未来发展产生积极影响。

五、相关审议程序

公司于2025年8月12日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意将部分超募资金4,833万元用于8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化。该事项尚需提交公司股东会审议。

六、专项意见

监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目，有利于增强公司竞争力，符合公司业务发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该项目的决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金新建募集资金投资项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

综上，保荐人对公司使用部分超募资金新建募集资金投资项目的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司使用部分超募资金新建募集资金投资项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

石建华　　李钦佩

中信证券股份有限公司

2025年 8月13日